

烟台德邦科技股份有限公司

关于公司变更部分募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 原募投项目: 年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目（以下简称“原项目”）
- 变更后募投项目: 德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目（以下简称“新项目”或“本项目”）。

新项目实施主体为深圳德邦界面材料有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳德邦”），项目总投资金额 23,049.54 万元，拟使用原项目剩余募集资金共计 6,236.99 万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准，下文同）用于新项目。新项目投资总额超出募集资金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。

- 变更募集资金投向的金额: 6,236.99 万元。
- 本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间: 新项目建设周期 2 年，将在项目建成后陆续投产并达到设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦科技”）分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年

产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”。

公司保荐机构东方证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。

募集资金总额扣除承销及保荐费（含税）人民币 135,894,306.56 元后的募集资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 535902385410508 的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字〔2022〕第 210029 号《验资报告》予以验证。

二、募集资金投资项目情况

根据《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《烟台德邦科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2023-014）和《烟台德邦科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048），截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	调整后投资 总额	累计投入 金额
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	38,733.48	38,439.15
2	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	11,166.48	6,241.99	5.00
3	新建研发中心建设项目	14,479.23	17,690.85	4,000.30
4	新能源及电子信息封装材料建设项目	30,776.20	30,776.20	24,540.61

序号	项目名称	募集资金	调整后投资	累计投入
		承诺投资总额	总额	金额
5	超募资金永久补流		55,305.80	55,353.00
合计		95,155.39	148,748.32	122,338.06

注：“超募资金永久补流”累计投入金额高于调整后投资总额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

三、本次变更部分募投项目的原因

(一) 原项目计划和实际投资情况

- 1、原项目名称：年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目
- 2、原项目实施主体：四川德邦新材料有限公司
- 3、原项目实施地点：四川彭山经济开发区产业大道 12 号
- 4、原项目建设内容：年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目实施完成后，可实现年产半导体芯片与系统封装用电子封装材料 15.00 吨、光伏叠晶材料 20.00 吨的产能。
- 5、原项目达到预定可使用状态日期：2026 年 9 月
- 6、原项目实际投资进度：截至 2025 年 6 月 30 日，年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目累计已实际投入募集资金 5.00 万元，该项目尚未使用的募集资金为 6,236.99 万元，存放于募集资金专户中。

(二) 本次变更部分募投项目的原因

本次对部分募投项目进行变更的主要原因如下：

- 1、公司原项目“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”，是结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定，并经过充分研究与论证。近年来，市场与行业环境发生深刻变化，原项目的产能扩张计划已不再具备先前的紧迫性。基于对当前市场环境和行业发展趋势的深入分析，结合公司整体战略规划，为更好地支持长远发展，公司决定终止该原项目。
- 2、通过新项目“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”的实施，公司有望实现多方面关键效果：一是摆脱租赁场地依赖，提升生产稳定性、以及生产效率与质量，为生产优化和研发提供稳定硬件载体；二是支撑产能扩张，助力公司达成营收增长目标；三是承接集团南方基地战略，依托深圳政策与产业优势，对接核心客户、优化供应链并吸引高端人才；四是巩固导热界面材料领域

竞争优势，保障订单响应、推动产品升级，巩固国产替代地位并助力细分市场拓展。

综上，本次将原募集资金投资项目“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”，是公司基于当前市场环境、行业趋势及自身战略规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，更好地把握市场发展机遇，应对行业变化挑战，对增强公司盈利能力、巩固核心竞争优势具有重要意义，具备充分的合理性与必要性。

四、新项目的具体情况

（一）基本情况

1、新项目名称：德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目
2、新项目实施主体：深圳德邦界面材料有限公司
3、新项目实施地点：广东省深圳市龙岗区洪围地块
4、新项目建设内容：本项目将与村集体合作开发一块工业用地，该地块已依据深圳专属政策完成农村用地向国有用地的性质转换，并在该地块新建厂房与宿舍，以解决深圳德邦现有租赁场地生产拥挤、实验室面积不足、布局不合理的问题；同时，项目将引入更先进的自动化生产设备，优化导热界面材料的生产工艺，提升导热界面材料和导电胶等核心产品的产能，并配套建设更完善的材料可靠性分析测试实验室，强化核心技术的迭代研发。

新项目产品主要为导热材料及 EMI 材料，细分为导热膏、导热泥、导热凝胶、导热垫片、相变材料、导电胶等，达产后预计年产能为 450 吨。

5、新项目实施周期：2 年
6、新项目资金：项目总投资金额 23,049.54 万元，拟使用原项目剩余募集资金 6,236.99 万元用于本项目。以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。

投资结构如下表所示：

序号	项目名称	项目投资总额	投资比例
1	建设投资	19,057.01	82.68%
1.1	工程费用	18,556.00	80.50%
1.1.1	建筑工程费	16,356.00	70.96%

序号	项目名称	项目投资总额	投资比例
1. 1. 2	设备购置费	2, 200. 00	9. 54%
1. 2	预备费	501. 01	2. 17%
1. 2. 1	基本预备费	501. 01	2. 17%
2	建设期利息	637. 90	2. 77%
3	铺底流动资金	3, 354. 63	14. 55%
4	项目总投资	23, 049. 54	100. 00%

7、新项目备案、环评情况

公司尚未取得用以实施本项目的土地的使用权，公司将在取得实施本项目的土地的使用权后及时办理项目备案和环评手续，后续公司将按照项目进展情况及时履行信息披露义务。

（二）必要性分析

1、自建厂房为业务规模持续扩张筑牢基础

自建标准化厂房是深圳德邦锚定中长期营收增长目标、实现业务规模持续扩张的关键战略举措，将从生产效能提升、研发能力突破、战略发展保障三大维度，为公司高质量发展筑牢坚实基础。

在生产运营层面，自建厂房可依据生产流程与工艺需求，科学规划生产区、仓储区、辅助区等功能板块，实现设备排布的最优布局与生产环节的无缝衔接，大幅提升生产流转效率；同时，充足且规整的操作空间能够从根本上消除安全隐患，构建安全高效的现代化生产体系，为产能稳步爬坡提供可靠保障。

在技术研发层面，自建厂房将配套建设规模化、专业化的研发检测中心，不仅可充分容纳 DSC、TGA、激光粒度分析仪等先进检测设备，更能为研发团队开展高导热材料迭代、填料表面改性等核心技术攻关提供充足的实验空间，助力技术研发周期缩短与成果转化效率提升，强化公司技术创新的核心竞争力。

在战略发展层面，自有土地与厂房的产权属性，彻底打破租赁模式下的场地拓展限制与布局约束，既可以根据业务增长需求灵活扩容场地面积，也能够按照生产研发的个性化需求动态调整空间规划，为公司营收目标的稳步达成与业务版图的持续扩张，提供长期稳定、自主可控的场地支撑，确保公司发展节奏始终保持稳健向上的良好态势。

2、承接集团战略布局，最大化释放深圳政策与区位价值

深圳德邦作为德邦科技全资子公司，发展需紧密契合德邦科技整体战略规划。公司正打造南方基地，深圳在高新技术产业领域拥有丰富的政策支持资源，包括固定资产投资补贴、技术攻关资助、高端人才奖励等，同时具备完善的半导体、电子信息产业生态。深圳区域的人才、政策及产业链不仅将极大助力公司的导热界面材料业务发展，还能为公司带来参与重大项目的可能性，为公司集团战略落地提供关键支撑。

本项目所建设南方基地将承载我司在南方区域的运营，长期享受政策红利、降低投资与运营成本，充分融入深圳的产业生态，依托区位对接核心客户、优化供应链，吸引高端人才，为公司深耕南方市场奠定基础，推动集团整体战略布局的高效落地。

3、保障产能匹配市场需求，巩固并强化核心竞争优势

从市场与自身实力来看，深圳德邦已具备坚实的竞争基础，作为国家科技重大专项的产业化平台，其在导热界面材料领域拥有多项已授权发明专利，同时还有大批专利处于申请流程中，核心产品量产，服务各领域龙头企业，部分产品还实现了国产替代甚至独家供应，市场认可度与客户黏性极高。当前相关领域市场需求持续攀升，带来广阔的市场机遇及增长空间。充足灵活的产能支撑，是高效承接市场订单、深化与头部客户战略合作、持续巩固并提升公司行业竞争优势的关键前提。

自建厂房可优化生产布局、引入先进设备，提升效率与产品质量，保障产能匹配需求，巩固公司核心竞争优势。此外，配套完善后的测试实验室将助力技术研发，推动核心技术迭代，开发高性能产品，巩固国产替代地位，增强客户信心，拓展市场份额，强化公司核心竞争优势。

（三）可行性分析

1、国家政策支持导热界面材料行业发展

导热界面材料是我国电子信息产业高质量发展的关键支撑，其技术突破与产能提升直接关系到下游消费电子、新能源汽车、通信设备及数据中心等核心领域的散热效率、产品可靠性及产业竞争力。近年来，我国出台了一系列产业政策，支持和鼓励导热界面材料行业发展。国家产业政策的支持将为热界面材料市场带

来持续上行的市场前景，为本项目的实施营造了良好的政策环境。

2、本项目技术具备充分可行性且支撑项目落地运营

本项目聚焦导热界面材料生产，项目技术可行性的核心在于，核心生产技术成熟且具备落地条件，关键支撑技术已实现成熟应用，形成了完整的技术体系，可稳定支撑产品量产。

从技术研发与保障能力看，深圳德邦实力强劲，能为项目提供支撑：作为国家科技重大专项产业化平台，其研发体系与硬件基础完善，在导热界面材料领域拥有多项已授权发明专利，搭建了多个专业研究室及实验室，配备先进测试仪器与可靠性分析设备，可满足技术迭代与质量检测需求；研发团队由陈田安博士领军，专职研发力量配置充足，且以股权激励绑定核心人才，能持续推动材料优化与工艺改进，为项目技术升级提供人力与研发保障。

在生产工艺与质量控制上，项目技术可行性有充分验证：生产端形成成熟工艺体系，通过表面改性、分步加料搅拌保障高填料下材料柔韧性与流动性，用精密压延或模具成型控导热垫片厚度公差，借真空搅拌脱泡保产品致密可靠；质量端获 ISO9001 等多项认证，设专职团队，全流程管控质量，符合宁德时代等核心客户要求，印证技术在生产与市场应用中的可行性。

3、本项目用地具备明确可行性且获取过程合法合规

土地性质转换合规无法律风险，项目用地原为村集体用地，后续将严格遵循深圳市特有的政策流程，完成农村用地向国有用地的转换。该转换路径是深圳土地管理体系内的成熟合规模式，完全契合当地土地管理专项要求，不存在性质转换层面的法律隐患。

土地用途与项目需求高度适配，该用地已明确划定为工业用地，与项目核心需求——建设厂房开展导热界面材料的生产、研发及配套工作完全匹配。不仅能支撑深圳德邦科学划分生产区、研发区、检测区等功能区域，更可直接为产能扩张、技术研发提供适配场地，有力保障深圳德邦中长期营收目标与规模目标落地。

合作开发获取方式合规可行，项目采用村集体合作开发模式获取土地，该模式在深圳国有化转换后工业用地开发中具备实操基础。合作将严格遵循深圳集体用地合作开发流程，明确各方权责，确保开发全流程合规，无合作模式层面的合规隐患。

（四）经济效益分析

本项目整体建设期为两年，在实现前述预期产出的前提下，项目税后内部收益率处于良好区间，各项关键财务指标稳健，项目实施具备经济可行性。但若相关行业及市场等外部环境发生变化，则测算的内部收益率情况将随之发生变化。

五、风险提示

（一）市场风险

由于未来国际环境变化、宏观政策变化、市场供求状况、行业竞争情况、技术进步等因素存在一定的不确定性，“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”可能存在实施进度延缓或投资效益不达预期的风险。

（二）新建产能爬坡期的风险

随着新建产能的投入，厂房建造和装修费用开始摊销，生产相关设备也开始折旧，而产线通过体系认证需要时间，公司产品导入测试生产也需要时间，产能投入使用将呈现陆续爬坡的态势。若产能利用率爬坡速度较慢，则项目效益实现滞后，前述各项折旧摊销可能会影响公司净利润。

（三）项目实施风险

本项目尚需向政府有关部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

六、本次变更部分募集资金投资项目后的募集资金管理

为保障新募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向深圳德邦提供无息借款。

鉴于本次募投项目变更调整事项，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次募投项目变更调整相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续、办理增加募集资金专户相关事宜。若后续公司拟相应增加募集资金专户，公司将与保荐机构、募集资金专户银行签署募集资金专户监管协议，规范公司募集资金存放与使用。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。

七、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场、行业环境的发展变化，根据公司经营发展战略需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

八、公司履行的审议程序

公司分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。本议案尚需公司股东会审议。

九、专项意见说明

1、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”，是公司经过审慎分析后做出的决定，综合考虑了公司业务需求及项目实际实施情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

2、保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次变更部分募投项目，系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日